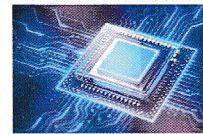


2025 インターンシップ・仕事体験 募集

LSIソリューション事業部（半導体設計）



A : アナログ回路設計

期間 : ① 3/3~3/7 ② 3/10~3/14

- ・機能の検討を行い、アナログ回路を設計します
- ・自分で設計した回路をシミュレーションし、実機を用いて評価します

B : ロジック回路設計（上級）

期間 : 3/3~3/7

- ・FPGAを用いてオシロスコープを設計します
 - ・仕様の検討を行いRTL設計から検証、FPGAマッピング、動作評価を実施します
- ※ 参加条件 : RTL記述の開発経験

C : ロジック回路設計（中級）

期間 : ① 3/3~3/7 ② 3/10~3/14

- ・FPGAを用いてカラーバーを設計します
 - ・仕様の検討を行いRTL記述及び高位合成(C/C++)から検証、FPGAマッピング、動作評価を実施します
- ※ 参加条件 : C言語もしくはRTL記述の開発経験

D : ロジック回路設計（初級）

期間 : 3/10~3/12

- ・FPGAを用いてAMラジオに電波を送信する回路を設計します
 - ・仕様の検討を行いRTL記述及び高位合成(C/C++)から検証、FPGAマッピング、動作評価を実施します
- ※ 参加条件 : C言語もしくはRTL記述の開発経験

E : レイアウト設計

期間 : 3/3~3/4

- ・半導体設計の最終工程であるレイアウト設計を行います
 - ・回路設計を基にCADを使用して基本セルや機能ブロックのレイアウトパターンを設計します
- ※パズルや絵を描くことが得意な方、CADを学んでいる方におススメです

F : 半導体製造におけるデータ分析

期間 : 3/10~3/11

- ・半導体製品の歩留(ぶどまり)を向上させるために必要なデータ分析を行います
 - ・歩留、不良解析について必要な理論と製造プロセスを説明します
- ※実験、数字、統計学、および原因究明が好きな方向きです

- 応募方法 : 就職情報サイト (マイナビ、リクナビ) からご応募ください
- 対象学年 : 2026年3月 卒業・修了予定者 (学部3年生、修士1年生)
- 実施場所 : 本社 (最寄駅 JR川崎)
- 旅費宿泊 : 交通費 : 実費支給 食事補助 : 支給あり ※必要な場合には宿泊先をご用意します
- お問い合わせ : 東芝情報システム株式会社 総務部 インターンシップ担当
tel: 044-210-6215 e-mail: TJsaiyo@ml.toshiba.co.jp

リクナビ



マイナビ

